

本人謹代表董事會（「董事會」）欣然提呈福邦控股有限公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零四年十二月三十一日止年度之全年業績。

財務業績

年內，本集團錄得營業額24,532,000美元，而二零零三年則為28,114,000美元。由於生產成本的上升，令毛利由去年之2,836,000美元下降至1,040,000美元。由於出售物業、廠房及設備之虧損減少，令虧損淨額收窄。然而，本集團仍然錄得淨虧損2,995,000美元，而二零零三年則為4,653,000美元。每股基本虧損為0.03美仙。

股息

董事會不建議就截至二零零四年十二月三十一日止年度派付末期股息（二零零三年：無）。

業務回顧

木材業務

有效推行成本控制措施，加上出售若干錄得虧損之木材附屬公司，令本集團木材業務於二零零四年之表現得以改善。儘管行業之競爭仍然激烈，但憑藉本集團之產品質素優異，故仍能領先市場。年內，本集團大部份木材相關產品（包括木芯板、刨花板及門皮）之經營業績均見改善。

本集團擁有67%權益之附屬公司吉林福敦木業有限公司（「福敦」）為於中國生產模製門皮之專家。年內，本集團之優質模製門皮錄得理想的毛利率，且市場需求穩定。為了進一步加強此收入來源，本集團之銷售及市場推廣隊伍已就產品之數個潛在海外市場進行評估，並已成功把產品系列引入中東市場。

為了降低生產成本，本集團把其擁有51%權益之附屬公司瀋陽福昇中密度板有限公司（「福昇」）搬遷至瀋陽市郊區。福昇之業務為製造及銷售中密度板。工廠在搬遷後自二零零五年四月初起重新投產，令生產成本減少10%以上。

高科技相關業務

傳統集成電路之提升版一系統整合晶片（「SoC」）為精密的集成電路（「集成電路」），於一片晶片中嵌入精密的系統及裝置，使製造商得以製造體積細小之產品及減低生產成本。SoC日漸成為資訊及電子業界之主要組件，包括無線、寬頻通訊及數碼消費電子業界。憑藉管理層之雄厚科技背景及專業知識，本集團已為其高科技相關業務建立穩固的基礎。

本集團專注於技術項目之分支機構—福華先進微電子股份有限公司（「福華先進」）為一家無廠房SoC原設計製造商，為大中華地區半導體市場提供SoC及以SoC為本之解決方案。除了向客戶提供集成電路設計及以平台為本的SoC服

務外，福華先進亦提供重新確定目標服務。福華先進與主要品牌晶片公司合作，協助彼等結合新晶片加工技術及新鑄造法，對現有產品進行重塑設計，以降低成本及增強產品功能，同時減低地區風險及提高生產力。

隨著愈來愈多半導體製造商把廠房搬遷至亞洲地區，特別是中國，中國將於不久將來成為全球最大的半導體市場。為了抓緊市場上的未來商機，本集團已積極提升其在區內之知名度。於二零零五年三月中在中國上海市舉行之二零零五年中國國際半導體設備與材料展覽暨研討會上，福華先進向潛在客戶推介其專用積體電路服務。專用積體電路為一站式服務，有助客戶節省設計及製造SoC所需資源，並可縮短產品推出市場之時間。直至目前為止，市場反應良好。

福華先進獨特的業務模式及其由矽谷及台灣集成電路專才組成之專業隊伍，吸引資本投資，使其得以拓展業務。福華先進在台灣、中國、美國及日本等地均設有辦事處，這網絡有助本集團加強設計實力及贏取於潛在客戶群內的知名度。

未來計劃及前景

展望未來，福邦將繼續改善整體營運效率，以及增撥更多資源至木材業務旗下錄得盈利之業務。此外，本集團亦將繼續開拓不同的海外市場、拓展銷售渠道及提升品牌形象。

高科技相關業務方面，本集團認為隨著愈來愈多半導體工廠搬遷至亞洲地區，SoC市場於未來數年將會高速增長。鑑於該等製造商尋求外判SoC生產業務，福華先進當可因而受惠。福邦將會充份發揮其管理層在科技界之人脈網絡及專業知識，以及福華先進之獨特業務模式，爭取SoC市場之發展良機。預期是項業務將會成為本集團未來業績之主要收入來源。

本集團將於二零零五年下半年推出應用先進SoC技術的全新原設計產品，當中包括內置MP3的Boom Box。由於上述產品價格具競爭力，質素優異且功能超卓，故本集團有信心上述新產品將可帶來大量訂單。

致謝

本人謹此代表董事會向全體股東、董事、員工、客戶、供應商及業務夥伴致以深切謝意，感謝他們對本集團一直以來之鼎力支持。

承董事會命

主席

楊丁元

香港，二零零五年四月二十二日